



Каталог металлокерамических корпусов для изделий СВЧ-электроники

Москва

2021

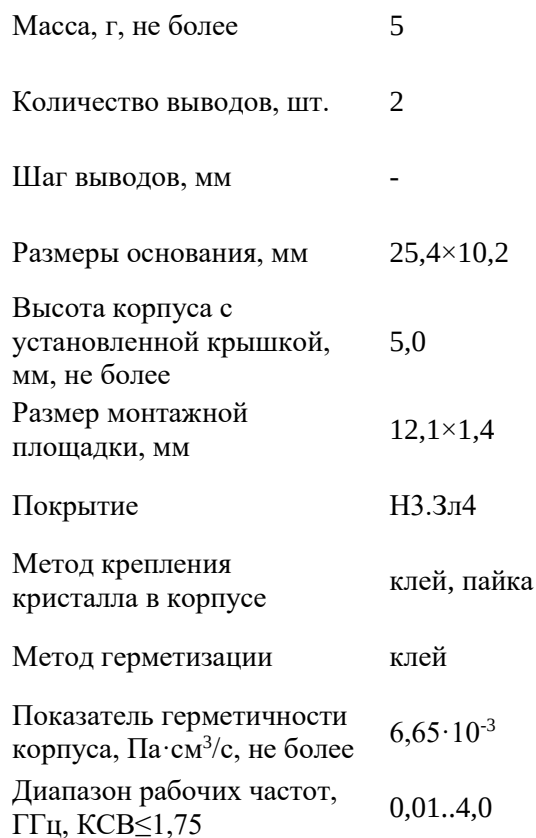


Оглавление

Корпуса для мощных СВЧ транзисторов.....	3
Корпус ТЛВШ.432269.001 с диапазоном частот до 4 ГГц	3
Корпус ТЛВШ.432269.003 с диапазоном частот до 12 ГГц	4
Корпус ТЛВШ.432269.004 с диапазоном частот до 4 ГГц	5
Корпуса для мощных СВЧ МИС и ГИС.....	6
Корпус ТЛВШ.301175.004 с диапазоном частот до 7 ГГц	6
Корпус ТЛВШ.301175.005 с диапазоном частот до 17 ГГц	7
Корпус ТЛВШ.301175.006 с диапазоном частот до 18 ГГц	8
Корпус ТЛВШ.301175.007 с диапазоном частот до 18 ГГц	9
Корпус ТЛВШ.301175.008 с диапазоном частот до 20 ГГц	10
Корпус ТЛВШ.301175.009 с диапазоном частот до 22 ГГц	11
Корпус ТЛВШ.301175.010 с диапазоном частот до 20 ГГц	12
Корпус ТЛВШ.432269.011 с диапазоном частот до 18 ГГц	13
Корпус ТЛВШ.301175.011 с диапазоном частот до 18 ГГц	14
Корпус ТЛВШ.301175.012 с диапазоном частот до 18 ГГц	15
Корпус ТЛВШ.301175.013 с диапазоном частот до 18 ГГц	16
Корпус ТЛВШ.301175.014 с диапазоном частот до 18 ГГц	17
Корпус ТЛВШ.301175.015 с диапазоном частот до 18 ГГц	18
Корпус ТЛВШ.301175.016 с диапазоном частот до 16 ГГц	19

Корпус ТЛВШ.432269.001 с діапазоном частот до 4 ГГц

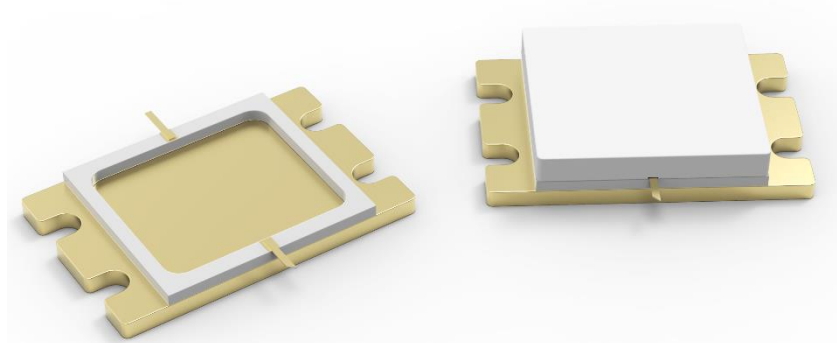
Технические характеристики



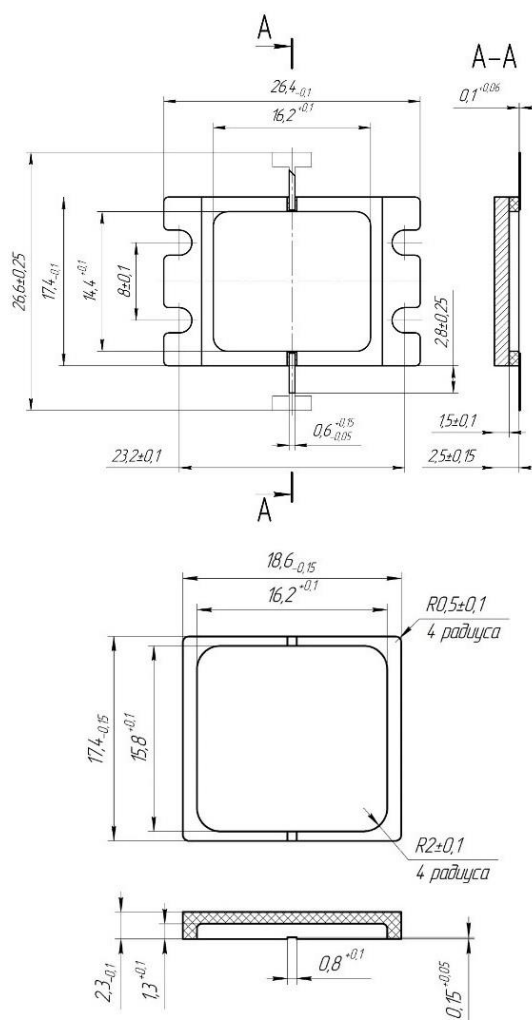
**Корпус ТЛВШ.432269.001– со вставкой
из ALN-230 керамики;**

Корпус ТЛВШ.432269.001-01 – со вставкой из ВеО керамики.

Корпус ТЛВШ.432269.003 с диапазоном частот до 12 ГГц



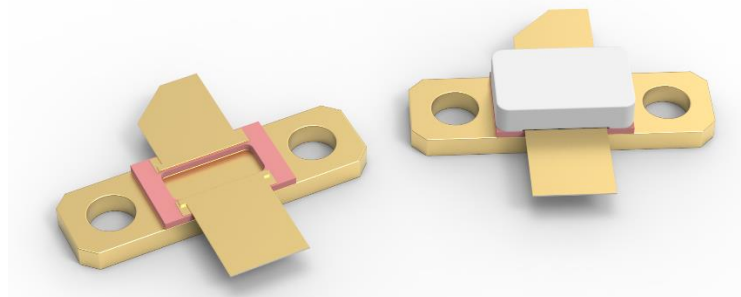
Габаритный чертеж



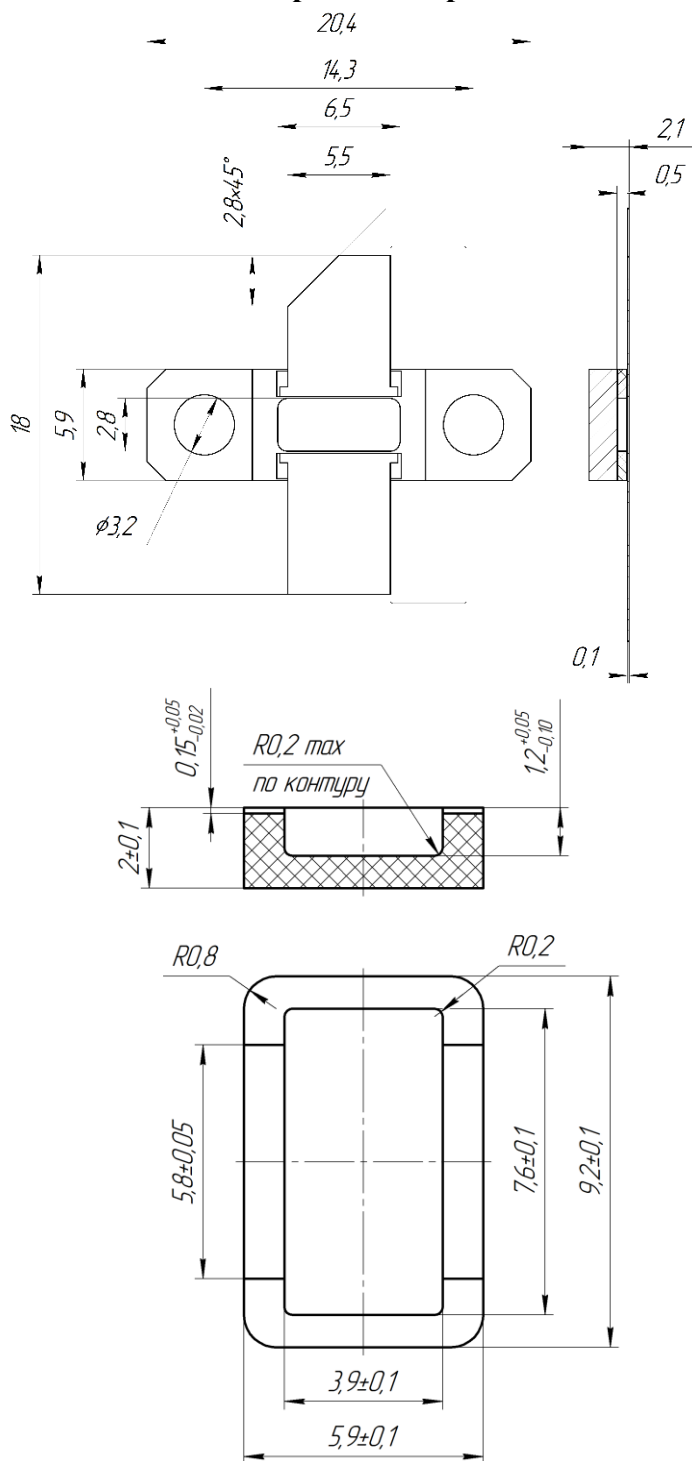
Технические характеристики

Масса, г, не более	5
Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	26,4×17,4
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	5,0
Размер монтажной площадки, мм	16,2×14,4
Покрытие	НЗ.Зл4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	$6,65 \cdot 10^{-3}$
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..12,0

Корпус ТЛВШ.432269.004 с диапазоном частот до 4 ГГц



Габаритный чертеж

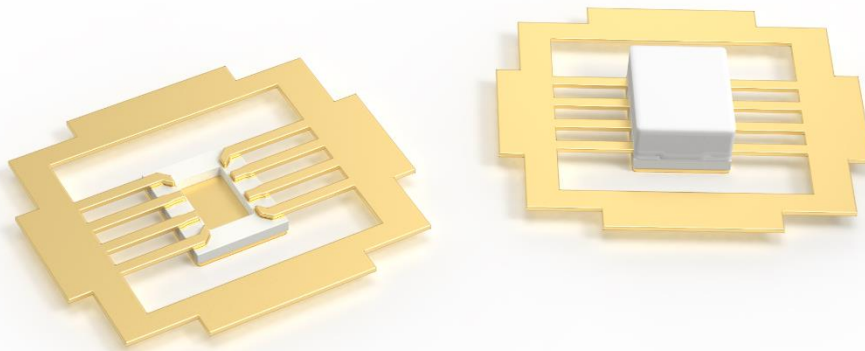


Технические характеристики

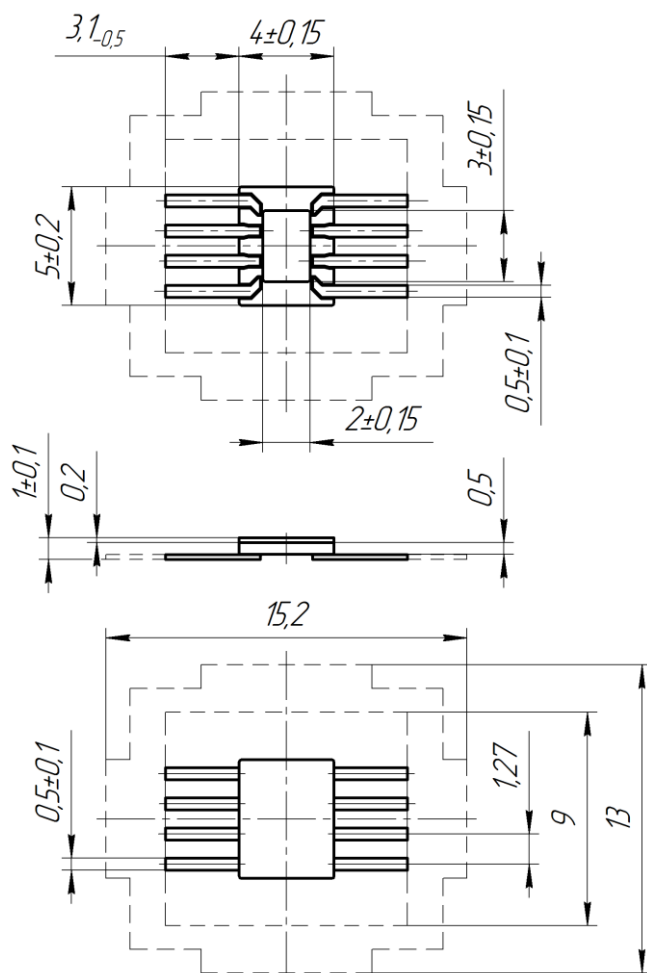
Масса, г, не более	4
Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	20,4×5,9
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	2,5
Размер монтажной площадки, мм	6,5x2,8
Покрытие	НЗ.Зл4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	$6,65 \cdot 10^{-3}$
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ ≤ 1,75	0,01..4,0

Корпуса для мощных СВЧ МИС и ГИС

Корпус ТЛВШ.301175.004 с диапазоном частот до 7 ГГц



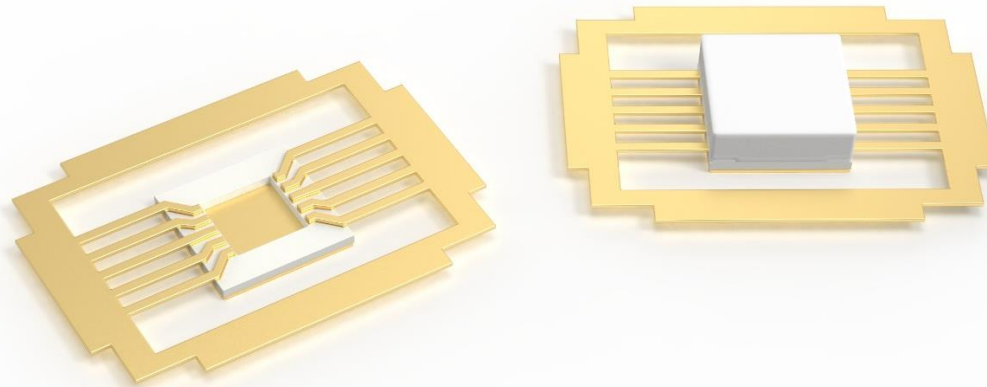
Габаритный чертеж



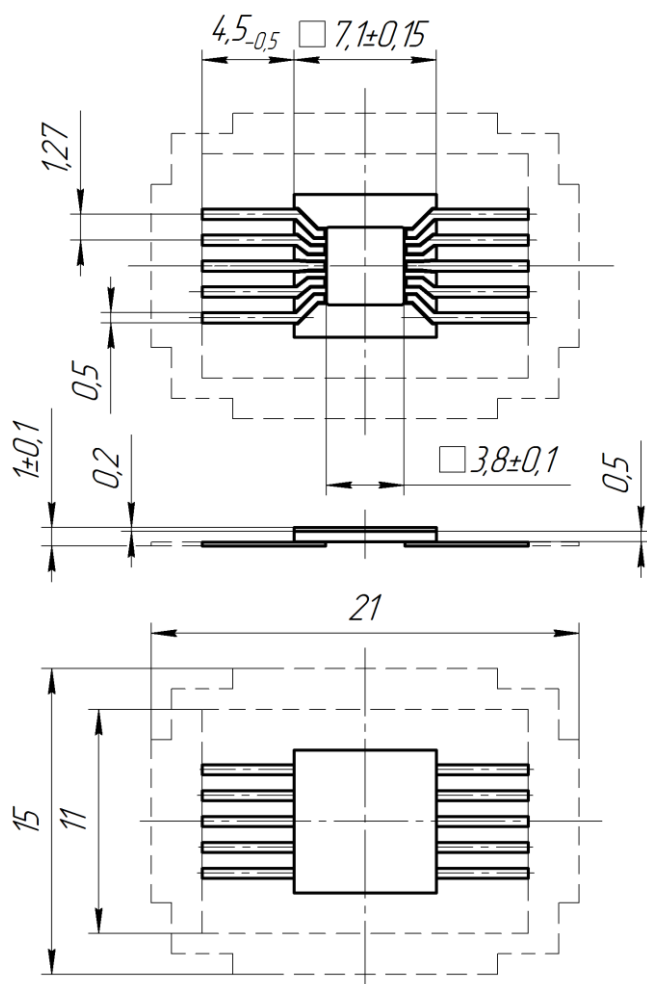
Технические характеристики

Масса до обрезки выводной рамки, г, не более	0,5
Масса после обрезки выводной рамки, г, не более	0,3
Количество выводов, шт.	8
Шаг выводов, мм	1,27
Размеры основания, мм	4×5
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	3
Длина выводов, мм, не менее	2,6
Размер монтажной площадки, мм	2×3
Покрытие	НЗ.3л4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..7,0

Корпус ТЛВШ.301175.005 с диапазоном частот до 17 ГГц



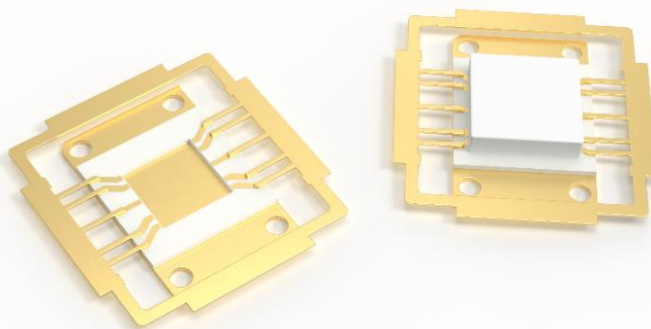
Габаритный чертеж



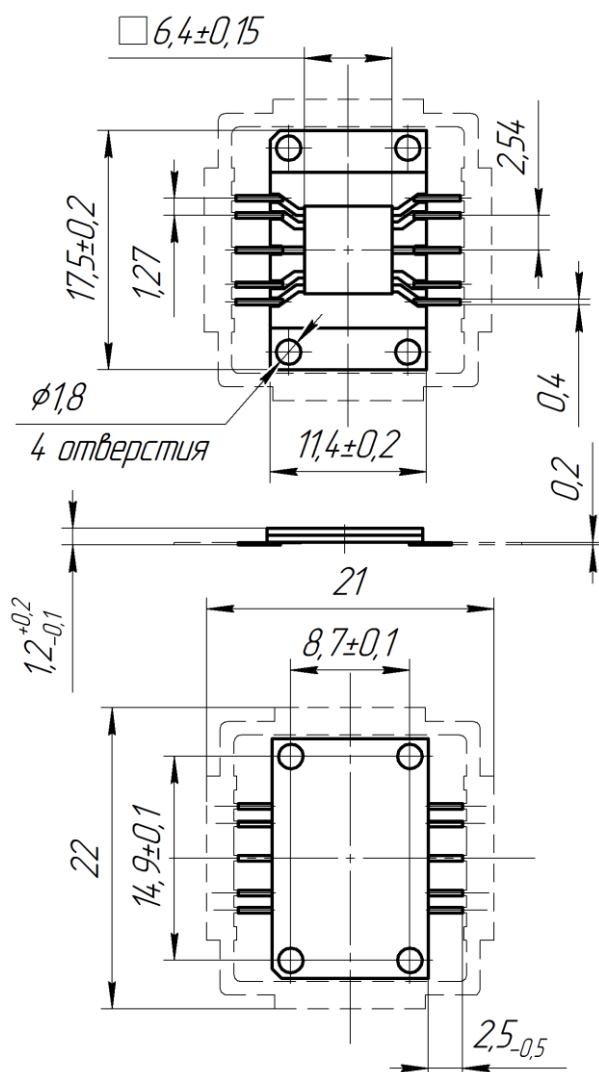
Технические характеристики

Масса до обрезки выводной рамки, г, не более	0,8
Масса после обрезки выводной рамки, г, не более	0,5
Количество выводов, шт.	10
Шаг выводов, мм	1,27
Размеры основания, мм	7,1 $\times$ 7,1
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	3
Длина выводов, мм, не менее	4
Размер монтажной площадки, мм	3,8 $\times$ 3,8
Покрытие	Н3.3л4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па $\cdot$ см ³ /с, не более	6,65 $\cdot$ 10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ $\leq$ 1,75	0,01..17,0

Корпус ТЛВШ.301175.006 с диапазоном частот до 18 ГГц



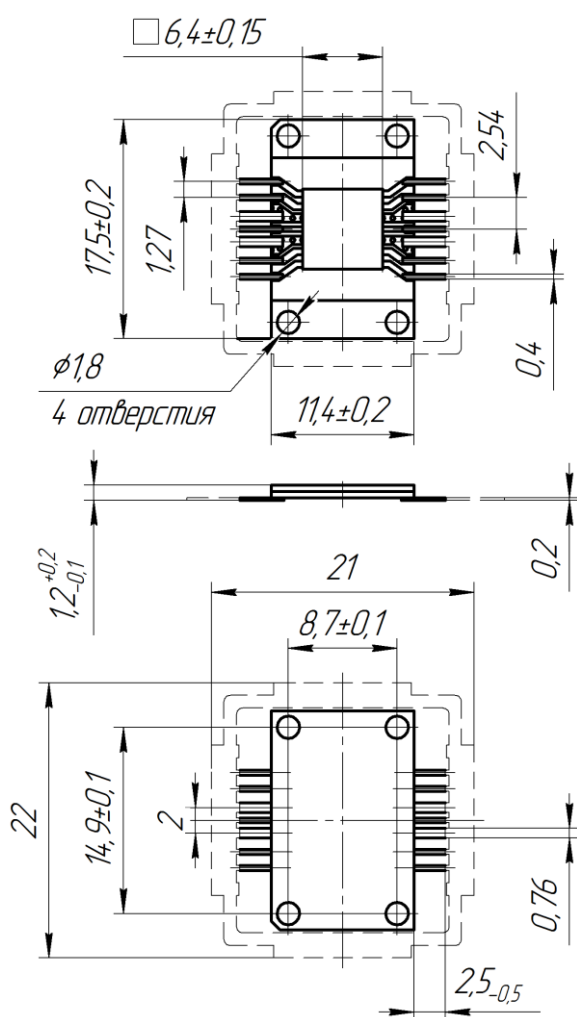
Габаритный чертеж



Технические характеристики

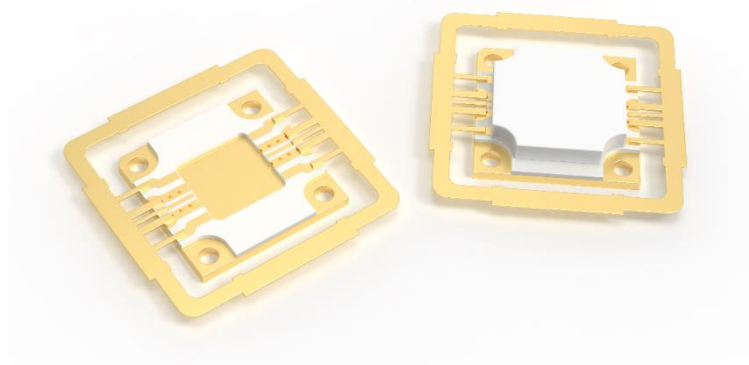
Масса до обрезки выводной рамки, г, не более	2,3
Масса после обрезки выводной рамки, г, не более	2
Количество выводов, шт.	10
Шаг выводов, мм	1,27 2,54
Размеры основания, мм	17,5×11,4
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	3,3
Длина выводов, мм, не менее	2
Размер монтажной площадки, мм	6,4×6,4
Покрытие	НЗ.Зл4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ ≤ 1,75	0,01..18,0

Технические характеристики

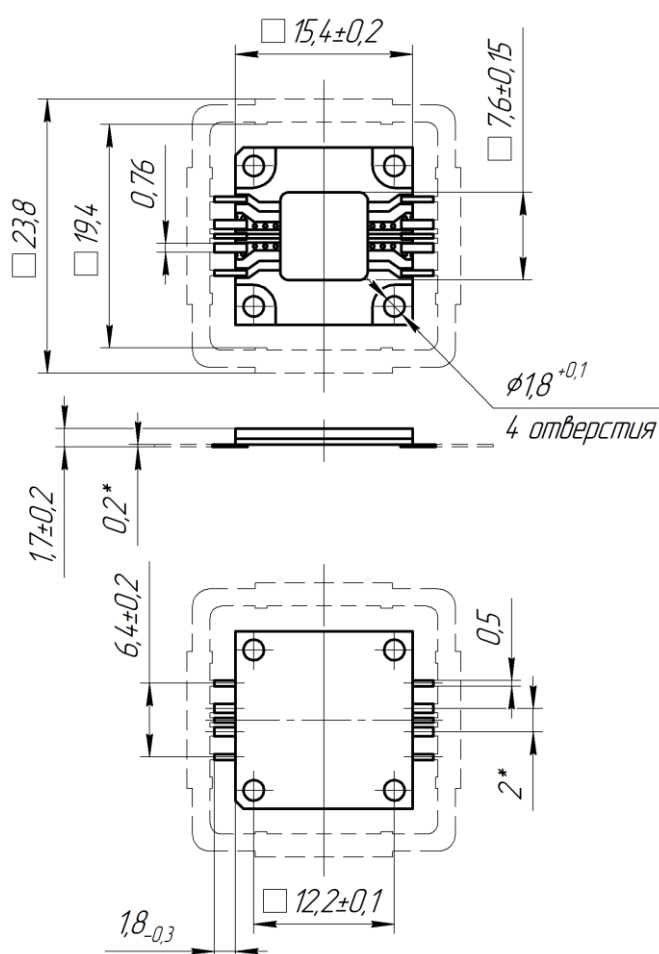


Масса до обрезки выводной рамки, г, не более	2,4
Масса после обрезки выводной рамки, г, не более	2,1
Количество выводов, шт.	14
	1,27
Шаг выводов, мм	2,54
Размеры основания, мм	17,5×11,4
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	3,3
Длина выводов, мм, не менее	2
Размер монтажной площадки, мм	6,4×6,4
Покрытие	НЗ.Зл4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..18,0

Корпус ТЛВШ.301175.008 с диапазоном частот до 20 ГГц



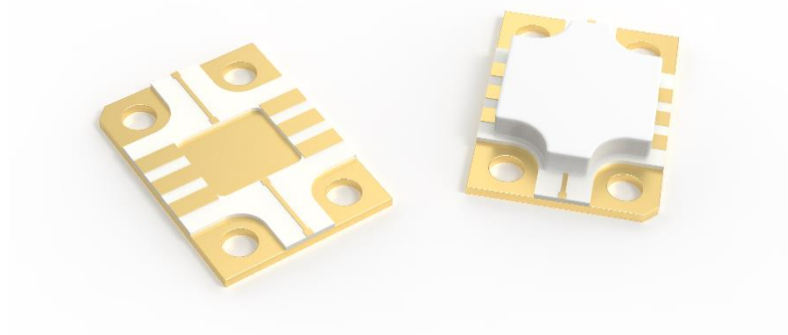
Габаритный чертеж



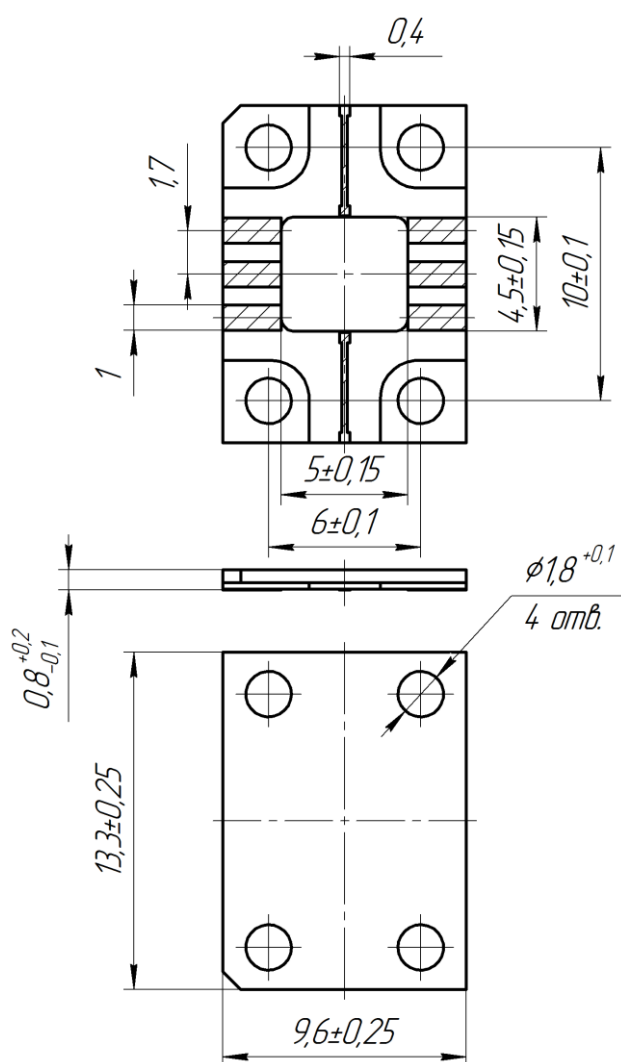
Технические характеристики

Масса до обрезки выводной рамки, г, не более	3,5
Масса после обрезки выводной рамки, г, не более	3,2
Количество выводов, шт.	10
Шаг выводов, мм	6,4 2
Размеры основания, мм	15,4×15,4
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	3,8
Длина выводов, мм, не менее	1,5
Размер монтажной площадки, мм	7,6×7,6
Покрытие	НЗ.Зл4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	$6,65 \cdot 10^{-3}$
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01...20,0

Корпус ТЛВШ.301175.009 с диапазоном частот до 22 ГГц



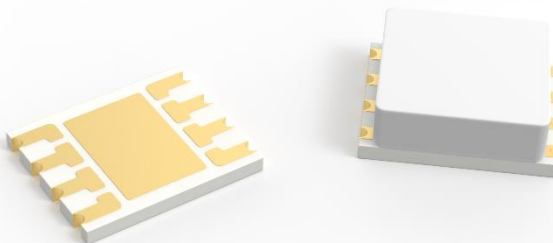
Габаритный чертеж



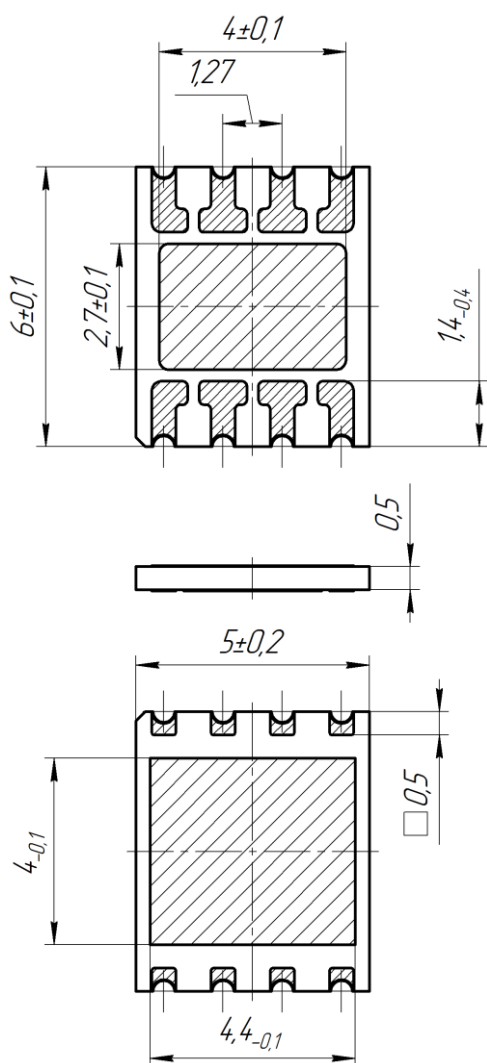
Технические характеристики

Масса, г, не более	1,2
Количество выводов, шт.	8
Шаг выводов, мм	1,7
Размеры основания, мм	13,3×9,6
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	2,5
Размер монтажной площадки, мм	5×4,5
Покрытие	НЗ.3л4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	$6,65 \cdot 10^{-3}$
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..22,0

Корпус ТЛВШ.301175.010 с диапазоном частот до 20 ГГц



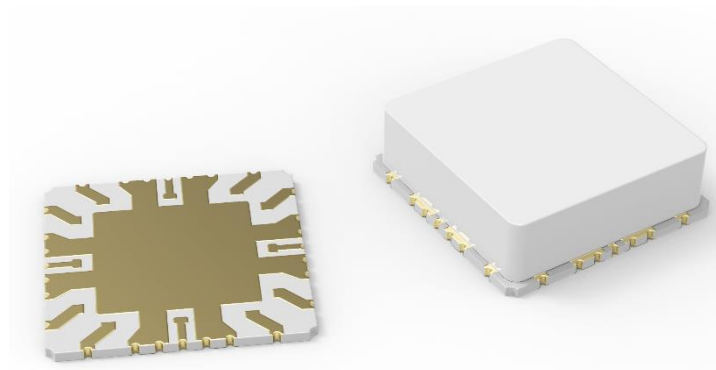
Габаритный чертеж



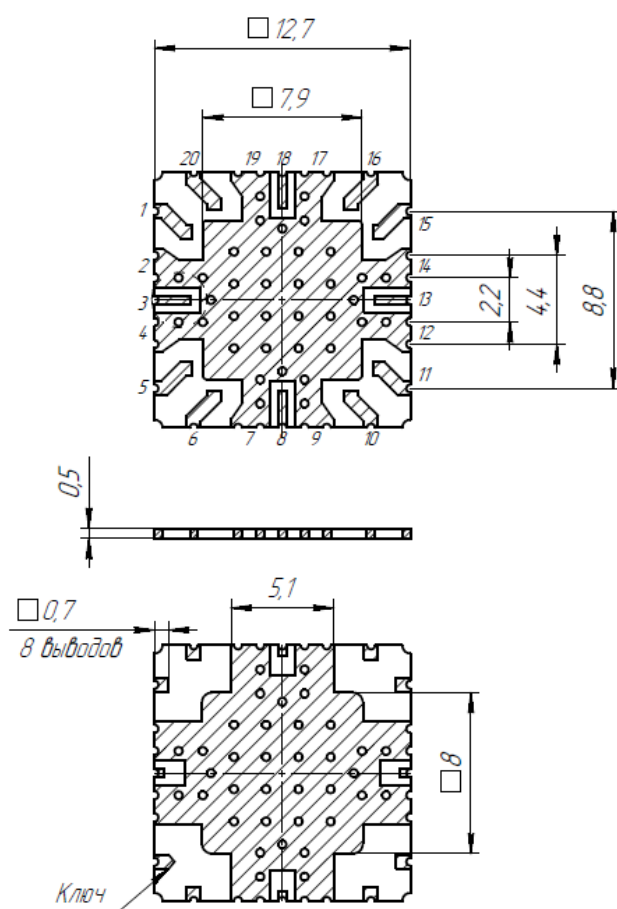
Технические характеристики

Масса, г, не более	0,3 (реал.0,18)
Количество выводов, шт.	8
Шаг выводов, мм	1,27
Размеры основания, мм	6x5
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	2,3
Размер монтажной площадки, мм	4x2,7
Покрытие	H3.3л4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	$6,65 \cdot 10^{-3}$
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ ≤ 1,75	0,01..20,0

Корпус ТЛВШ.432269.011 с диапазоном частот до 18 ГГц



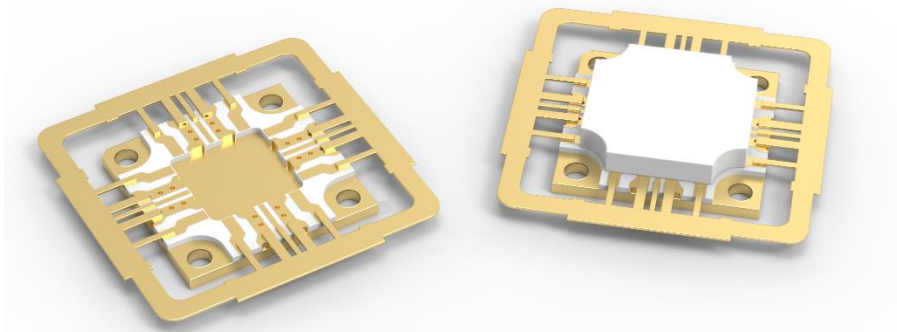
Габаритный чертеж



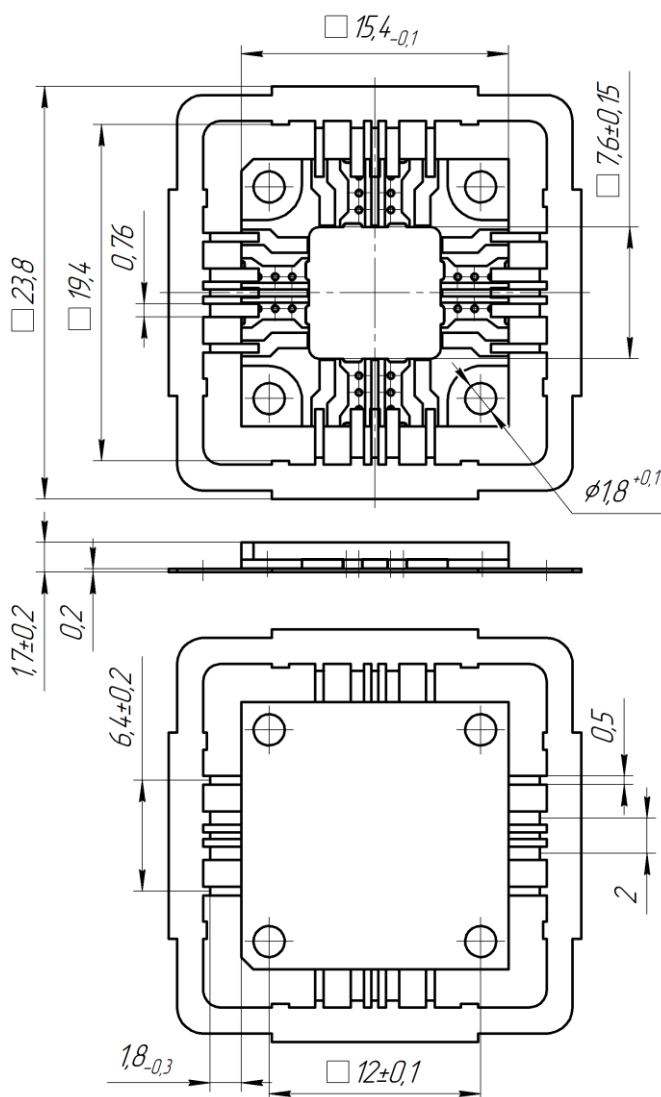
Технические характеристики

Масса, г, не более	1
Количество выводов, шт	20
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	12,7×12,7
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,5
Размер монтажной площадки, мм	8,0×8,0
Покрытие	НЗ.3л4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..18,0

Корпус ТЛВШ.301175.011 с диапазоном частот до 18 ГГц

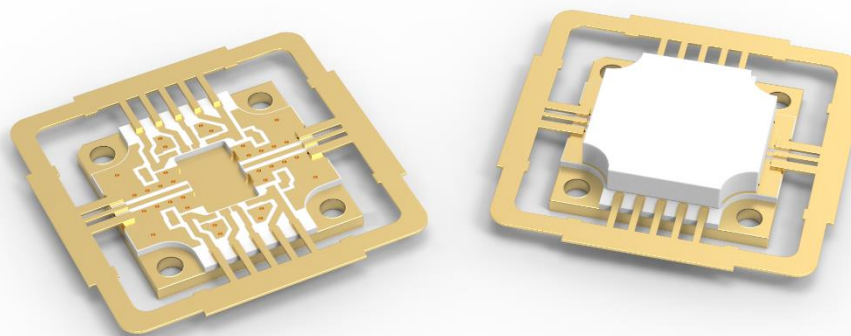


Габаритный чертеж

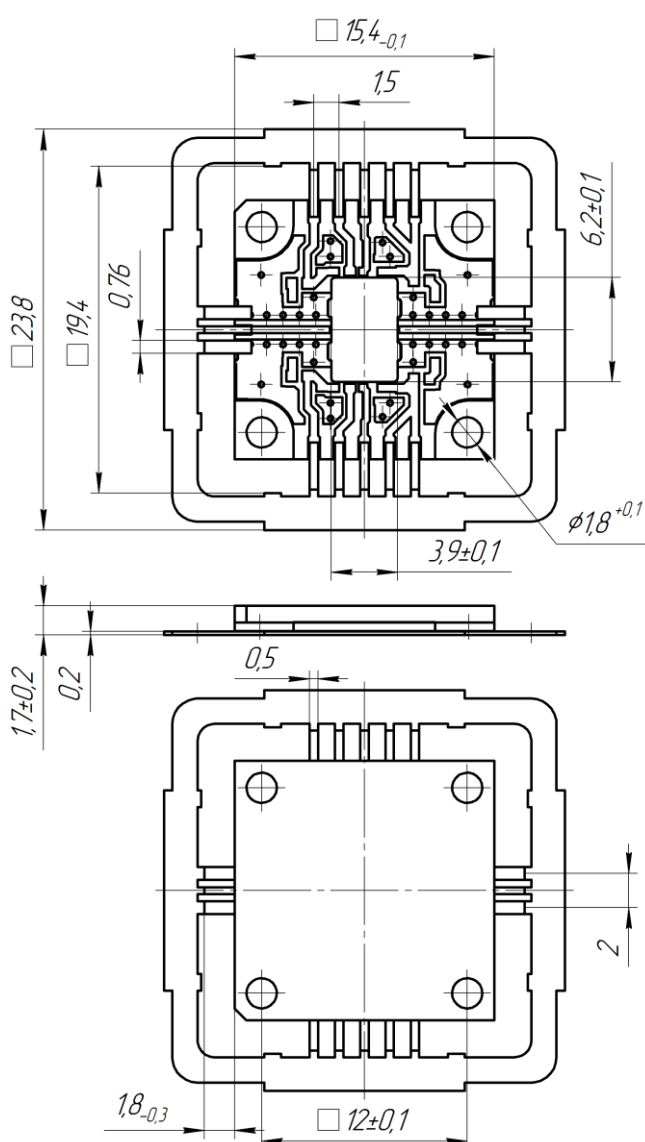


Технические характеристики

Масса до обрезки выводной рамки, г, не более	3,5
Масса после обрезки выводной рамки, г, не более	3,2
Количество выводов, шт.	20
Шаг выводов, мм	6,4 2
Размеры основания, мм	15,4×15,4
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	3,8
Длина выводов, мм, не менее	1,5
Размер монтажной площадки, мм	7,6×7,6
Покрытие	НЗ.Зл4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..18,0

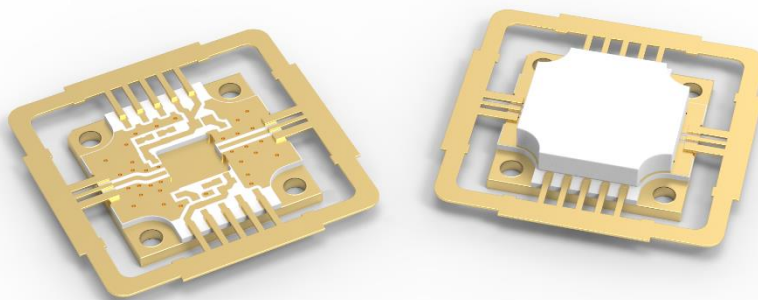


Технические характеристики

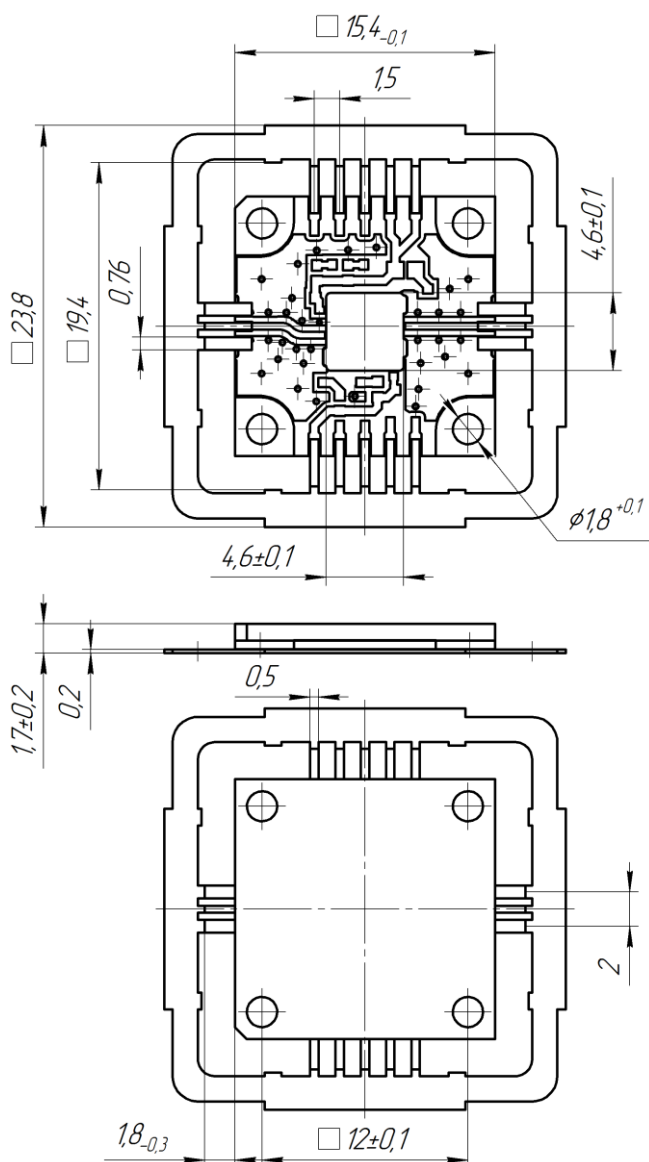


Масса до обрезки выводной рамки, г, не более	3,5
Масса после обрезки выводной рамки, г, не более	3,2
Количество выводов, шт.	16
Шаг выводов, мм	1,5 2
Размеры основания, мм	15,4×15,4
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	3,8
Длина выводов, мм, не менее	1,5
Размер монтажной площадки, мм	6,2×3,9
Покрытие	НЗ.Зл4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..18,0

Корпус ТЛВШ.301175.013 с диапазоном частот до 18 ГГц



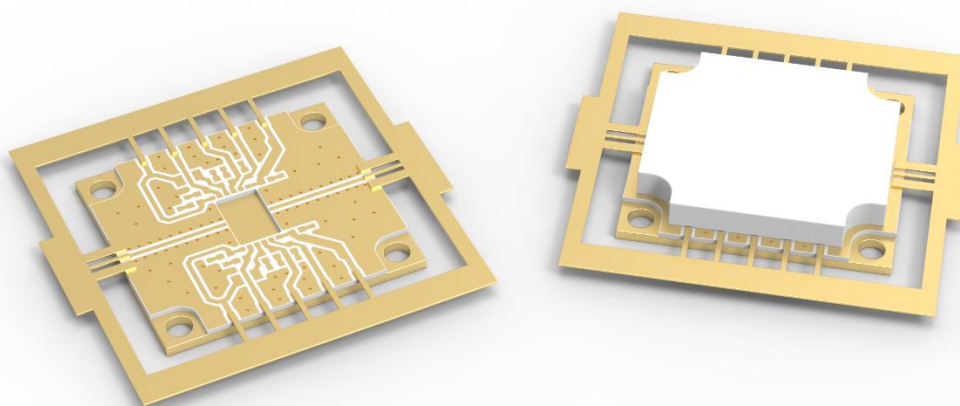
Габаритный чертеж



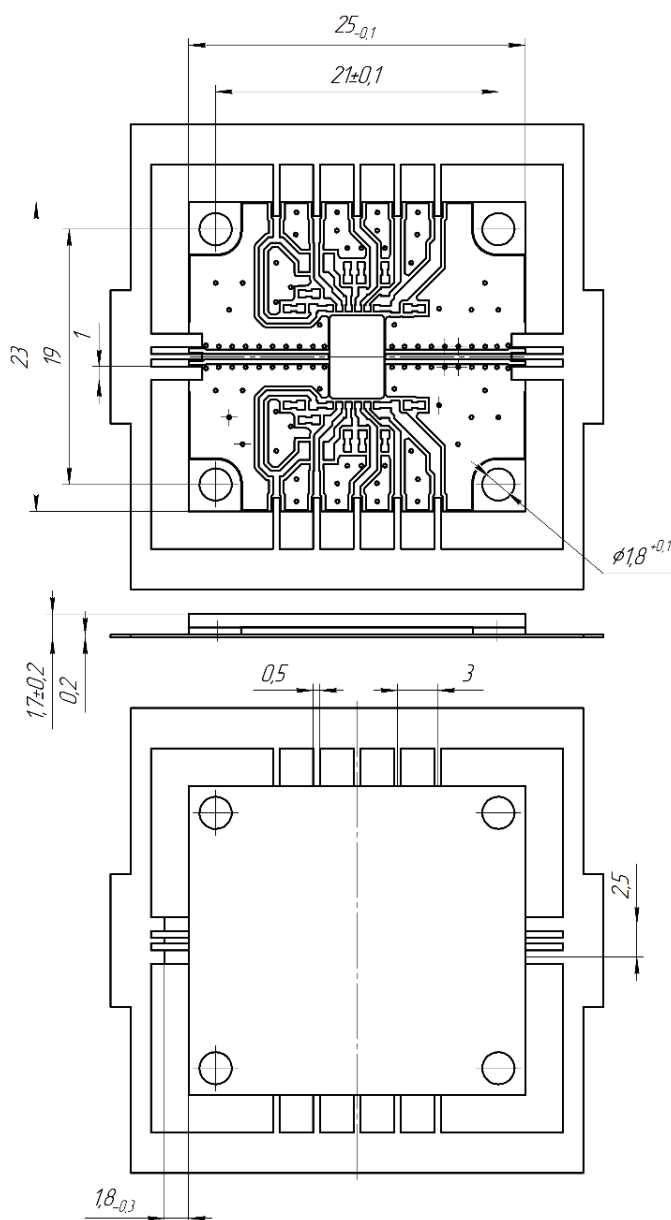
Технические характеристики

Масса до обрезки выводной рамки, г, не более	3,5
Масса после обрезки выводной рамки, г, не более	3,2
Количество выводов, шт.	16
Шаг выводов, мм	1,5 2
Размеры основания, мм	15,4×15,4
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	3,8
Длина выводов, мм, не менее	1,5
Размер монтажной площадки, мм	4,6×4,6
Покрытие	НЗ.Зл4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..20,0

Корпус ТЛВШ.301175.014 с диапазоном частот до 18 ГГц



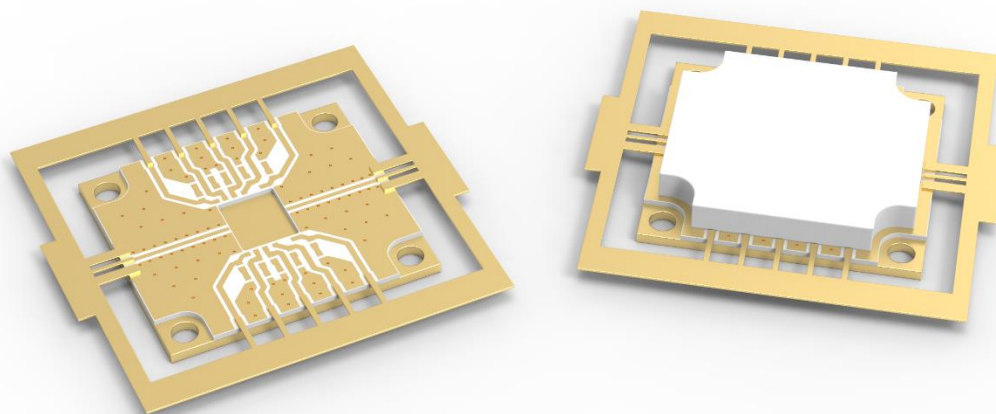
Габаритный чертеж



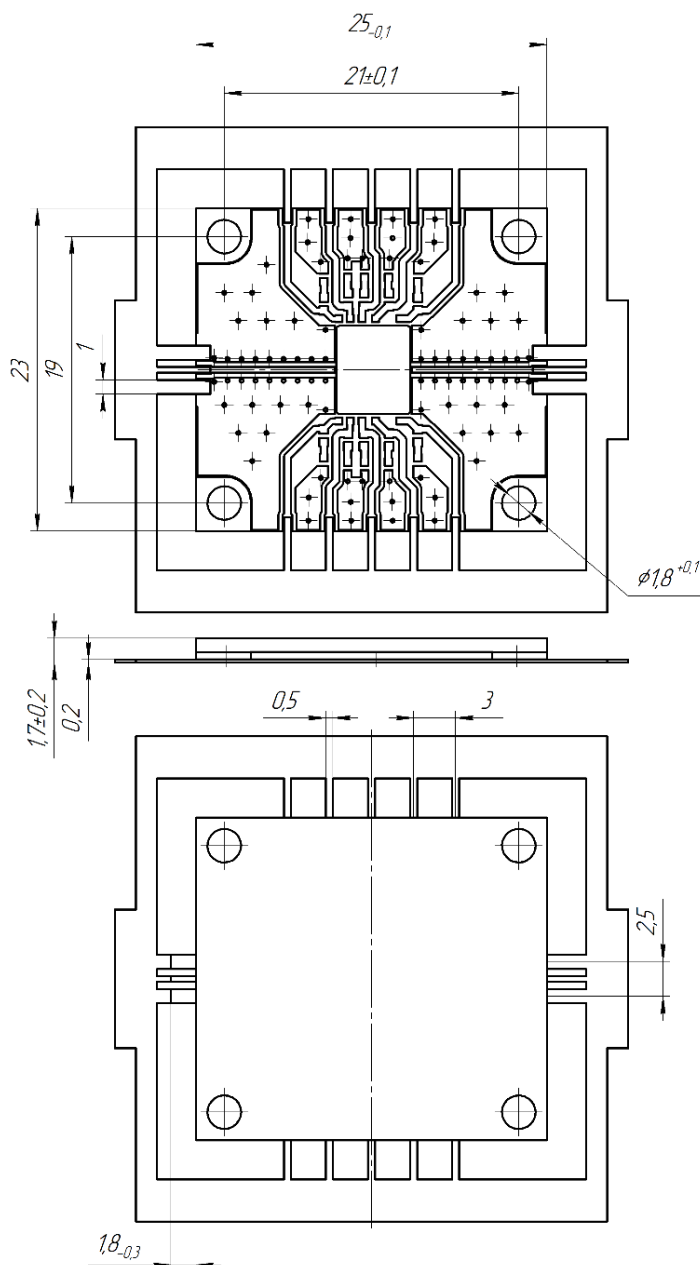
Технические характеристики

Масса до обрезки выводной рамки, г, не более	5,5
Масса после обрезки выводной рамки, г, не более	5,2
Количество выводов, шт.	16
Шаг выводов, мм	3 2,5
Размеры основания, мм	25×23
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,8
Длина выводов, мм, не менее	1,5
Размер монтажной площадки, мм	6,2×3,9
Покрывтие	НЗ.Зл4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	$6,65 \cdot 10^{-3}$
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..20,0

Корпус ТЛВШ.301175.015 с диапазоном частот до 18 ГГц



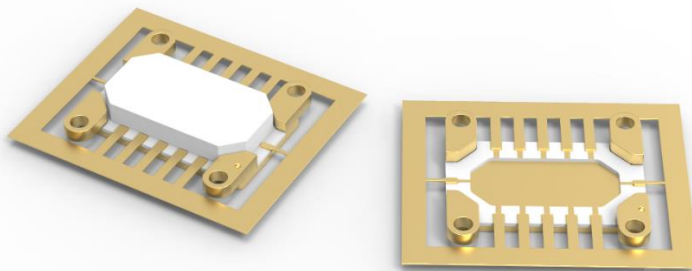
Габаритный чертеж



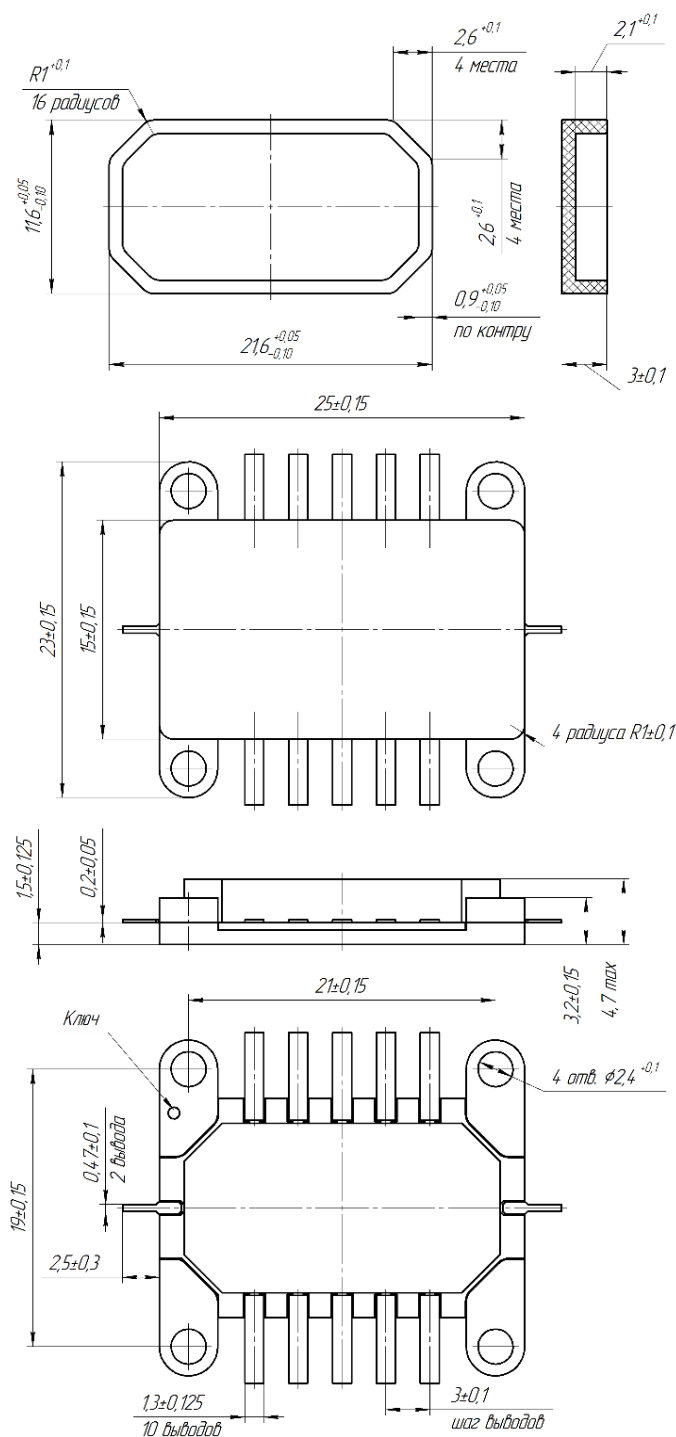
Технические характеристики

Масса до обрезки выводной рамки, г, не более	5,5
Масса после обрезки выводной рамки, г, не более	5,2
Количество выводов, шт.	16
Шаг выводов, мм	3 2,5
Размеры основания, мм	25×23
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,8
Длина выводов, мм, не менее	1,5
Размер монтажной площадки, мм	6,3×5,3
Покрытие	H3.3л4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	$6,65 \cdot 10^{-3}$
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ ≤ 1,75	0,01..20,0

Корпус ТЛВШ.301175.016 с диапазоном частот до 16 ГГц



Габаритный чертеж



Технические характеристики

Масса до обрезки выводной рамки, г, не более	5,5
Масса после обрезки выводной рамки, г, не более	5,2
Количество выводов, шт.	12
Шаг выводов, мм	3
Размеры основания, мм	25×23
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,7
Длина выводов, мм, не менее	2,5
Размер монтажной площадки, мм	18,8×8,8 (по углам 2,6×45°)
Покрытие	H3.3л4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, KCB≤1,75	0,01..16,0